

证券代码：301200

证券简称：大族数控

## 深圳市大族数控科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	花旗银行（11月1日） 中信证券（11月2日） 源乘投资（11月2日） 浑元资产（11月2日） 华夏未来资本（11月2日） 兴海荣投资（11月2日）
时间	2023年11月1日-2023年11月2日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸳
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司 2023 年前三季度整体经营情况</b></p> <p>受电子消费市场需求持续下滑影响，PCB 行业整体延续低迷态势，新增产能投资大幅减少，公司 2023 年前三季度累计实现营业收入 114,017.90 万元，同比下降 46.88%，归母净利润 15,943.00 万元，同比下降 60.16%。</p> <p>尽管电子终端市场需求普遍下滑，但随着 AI 服务器、汽车电子及智能手机功能的进一步增强，将促使相关 PCB 专用设备需求增长，公司对应开发的 CCD 六轴独立机械钻孔机、复合激光钻孔机、30μm 及以下超小孔激光钻孔机、高精度控深激光成型机、高</p>

	<p>精测试机等多类设备，有望成为公司下一阶段业绩增长的动力。</p> <p><b>二、多层板市场业务拓展情况</b></p> <p>普通多层板市场历经数十年发展，目前是最大的 PCB 细分市场，也是公司主要的收入来源，公司始终坚持在多层板市场的产品创新，推出的自动上下料机械钻孔机、自动插拔销钉机械成型机、自动外观检查机（AVI）、自动分拣包装机等自动化设备，大幅提升了下游 PCB 企业的产线稼动率并降低人力的投入，为 PCB 企业降本增效提供支撑，进一步提升公司市场地位。</p> <p>而在高多层板市场方面，公司推出的 CCD 六轴独立机械钻孔机、高对位精度激光直接成像机、大台面通用测试机及四线测试机等设备可满足通信设备、服务器、AI 加速器等应用领域高速产品的信号完整性对加工设备的高精度要求。</p> <p><b>三、HDI 板市场及 IC 封装基板领域新产品进展</b></p> <p>5G 智能手机、汽车自动驾驶等终端的普及和发展对 HDI（高密度互联）板的提出了更高的技术要求，从而拉动了 CO<sub>2</sub> 激光钻孔机、UV+CO<sub>2</sub> 复合激光钻孔机、高解析度激光直接成像机、高精测试机等设备需求的增长。公司将 HDI 板市场细分为不同终端应用场景，针对不同需求提供对应的解决方案。伴随国内电子终端品牌供应链国产化率提升的需求，将带动公司在 HDI 板市场份额的提升。</p> <p>在 IC 封装基板市场，公司多类产品取得突破，部分产品进入高阶 FC-BGA 封装基板加工领域。公司研发的高转速机械钻孔机、高精测试机产品获得国内多家龙头客户的认证并形成正式销售；运用新型激光技术开发出的用于高阶封装基板超高叠层、内埋高精度元器件等封装基板工艺的产品方案，获得了国际芯片厂商的技术认证；最新研发的±2.5μm 综合对位精度的高精专用测试设备，综合性能已能够对标全球封装基板测试设备龙头企业 Nidec-Read 的主流机型，相关产品市场份额有望实现提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 3 日